

46-702 / 46-703 Economy Version

Stiftleisten RM 1,27x2,54mm, gerade, 1-/2-reihig
Pin Headers, 1.27x2.54mm Pitch, Straight, Single/Double Row

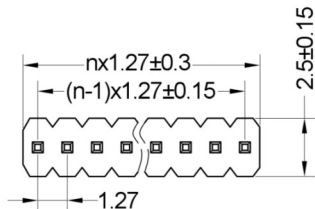
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Au über Ni <i>Au over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC/DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	230 °C für 30-60 Sekunden (260 °C für 10 Sekunden)

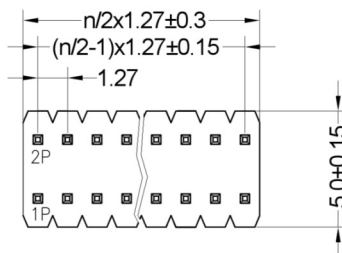
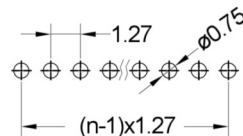


© W+P PRODUCTS

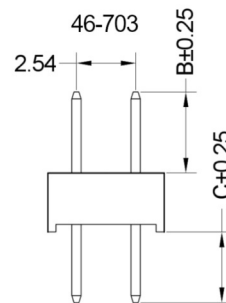
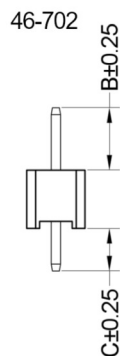
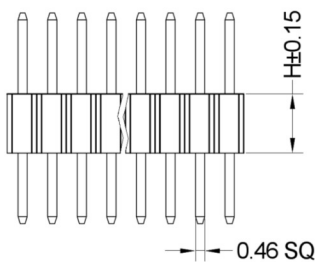
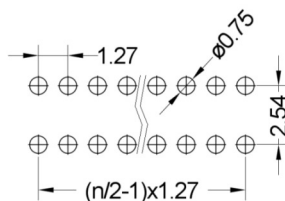
Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
46-709 46-710



Recommended P.C.B Layout (Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE ±0.05)



Recommended P.C.B Layout (Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE ±0.05)



Series *

46-702

46-702 Einreihig
Single row
46-703 Zweireihig
Double row

Contacts *

010

002-020 Einreihig (Dim. 10+20)
Single row (Dim. 10+20)
002-050 Einreihig (Dim. 30+40)
Single row (Dim. 30+40)
004-100 Zweireihig
Double row

Dimensions *

10

Einreihig:
Single row:
10 B=2,80 C=2,60 H=1,70mm
20 B=6,00 C=3,00 H=1,70mm
30 B=2,80 C=2,60 H=2,50mm
40 B=6,00 C=3,00 H=2,50mm
Zweireihig:
Double row:
50 B=2,80 C=2,60 H=2,50mm
60 B=6,00 C=3,00 H=2,50mm

Plating

00

00 Vergoldet
Gold plated

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

wppro.com/serie/XXX
wppro.com/en/serie/XXX

Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.

W+P
WE CONNECT IT

(+49) 5223 98507-0
sales@wppro.com

Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	untere Temperaturangabe [°C]
Verweildauer oberhalb T_L	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	obere Temperaturangabe [°C]
Dauer Höchsttemperatur	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	Lower Temperature [°C]
Duration above T_L	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	Upper Temperature [°C]
Duration Peak Temperature	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

